

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年3月29日(29.03.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/055859 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C09J 133/06 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2017/022969

(22) 国際出願日: 2017年6月22日(22.06.2017)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2016-182892 2016年9月20日(20.09.2016) JP

(71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森下 友亮 (MORISHITA, Tomotaka); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小升 雄一郎 (KOMASU, Yuichiro); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大谷 保, 外 (OHTANI, Tamotsu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目2 5 番 2 号 虎ノ門 E S ビル 7 階 特許業務法人 大谷特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: ADHESIVE SHEET FOR SEMICONDUCTOR PROCESSING

(54) 発明の名称: 半導体加工用粘着シート

(57) Abstract: The present invention relates to an adhesive sheet for semiconductor processing, the adhesive sheet being provided with: a base material; and an adhesive layer which is disposed on the base material and is formed of an adhesive composition. The adhesive composition includes: a polymer (A) that contains a reactive functional group (A1); a polymer (B) that contains a reactive functional group (B1) which is different from the functional group (A1), and that contains an actinic ray-polymerizable group (B2); a crosslinking agent (C) that reacts with the reactive functional group (A1); and a crosslinking agent (D) that reacts with the reactive functional group (B1).

(57) 要約: 基材と、前記基材上に設けられ、かつ粘着剤組成物により形成される粘着剤層とを備える半導体加工用粘着シートであって、前記粘着剤組成物が、反応性官能基 (A 1) を有するポリマー (A) と、反応性官能基 (A 1) とは異なる反応性官能基 (B 1) 及びエネルギー線重合性基 (B 2) を有するポリマー (B) と、反応性官能基 (A 1) と反応する架橋剤 (C) と、反応性官能基 (B 1) と反応する架橋剤 (D) とを含有する半導体加工用粘着シートに関する。

WO 2018/055859 A1